

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760m-ds3h-s1700-gen5-4ddr5-hdmi-dp-dsub-matx-p-372574.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna B760M DS3H s1700 GEN5 4DDR5 HDMI/DP/DSUB mATX

Cena brutto	455,99 zł
Cena netto	370,72 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIIEB760U12
Kod producenta	B760M DS3H GEN5
Kod EAN	4719331872793
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	256
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Karta dźwiękowa	Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 Wsparcie dla S/PDIF Out
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics 1 x Port D-Sub, obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200@60 Hz 1 x Port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz* Obsługa wersji HDMI 2.1 oraz HDCP 2.3.** Obsługa natywnyc
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 128 Mbit flash Używanie licencjonowanego BIOS-u AMI UEFI PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Procesor: 1 x Złącze M.2 (gniazdo 3, klucz M, typ 2280, obsługa SSD PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 1 x Złącze M.2 (gniazdo 3, klucz M, typ 2280, obsługa SSD PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB) 4 x Złącza SATA 6 Gb/s
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM)
Częstotliwość szyny pamięci	4400 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5

Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
RAID	Tak
Chipset	Intel B760
Funkcje specjalne	Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus Obsługa Smart Backup
Uwaga	CE+WEEE
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Liczba gniazd DDR5	4
Wymiary	24.4 x 17.4 cm
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 1
Złącza dostępne na płycie	4 x USB 2.0/1.1
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Tak
Rodzina procesora	Intel Core i7

Opis produktu

B760M DS3H GEN5

- Wydajność PCIe Gen5: Doskonała synchronizacja, by wygrać
- Obsługuje procesory Intel Core 14. / 13. / 12. generacji
- EZ-Latch: Złącze PCIe 5.0 x16 z szybkim systemem zwalniania
- PCIe UD Slot: Zbrojone złącze PCIe 5.0 (SMD) zapewniające lepsze wsparcie dla kart graficznych
- Niezrównana wydajność: Hybrydowy układ zasilania 6+2+1 faz
- Dwukanałowy DDR5: 4 gniazda DIMM z obsługą pamięci XMP
- Szybkie sieci: LAN 2.5GbE
- Pamięć nowej generacji: 2 złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Rozszerzona łączność: Tyłne porty USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI, D-Sub
- Smart Fan 6: Wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: Aktualizacja BIOS-u bez instalacji CPU, pamięci i karty graficznej

Ekspres do wydajności PCIe5

Nowe płyty główne GIGABYTE B760 oferują najwydajniejsze rozwiązanie, by cieszyć się pełnią możliwości PCIe Gen5 na obecnej platformie. PCIe 5.0 podwaja szybkość transmisji danych w porównaniu do PCIe 4.0 z 16 GT/s do 32 GT/s na linię. To znaczne zwiększenie przepustowości szczególnie korzystne jest dla wydajnych kart graficznych, urządzeń pamięci masowej i akceleratorów AI wymagających szybkiego przesyłania danych.

Trwała wydajność

Płyty główne GIGABYTE Ultra Durable, zbudowane z najlepszych komponentów, zapewniają najwyższą wydajność i trwałość.

Złącze zasilania UD

Innowacyjna konstrukcja złącza UD Power Connector poprawia przewodnictwo i odprowadzanie ciepła.

Lite pinów



Zapewnia doskonałe przewodzenie i transmisję sygnału oraz zmniejsza zużycie metalu przy wielokrotnym podłączeniu.

Chłodzenie VRM

Wytrzymałe radiatory sekcji zasilania (VRM) utrzymują system w chłodzie i sprawności.

Smart Fan 6

Chłodzenie. Cisza. Personalizacja.

Hybrydowa konstrukcja VRM

Najlepszy projekt VRM z najwyższej jakości komponentami. Zapewnia lepszą wydajność systemu i maksymalną skalowalność sprzętową.

Odblokuj wydajność DDR5

GIGABYTE oferuje sprawdzoną i przetestowaną platformę z ekstremalnym przyspieszeniem pamięci RAM.

Łączność przyszłości

Najwyższy poziom łączności z oszałamiającymi prędkościami transferu danych dzięki sieci i pamięci nowej generacji.

2.5G LAN

Konstrukcja zapewniająca błyskawiczne prędkości przesyłu danych oraz stabilność transmisji, nawet podczas pracy w chmurze lub przy usługach obliczeniowych zewnętrznych.

Połączenia przyszłości - USB 3.2 Gen 2 Type-C

USB 3.2 Gen 2 oferuje porty o prędkości do 10 Gb/s. Dzięki dwukrotnie większej przepustowości względem poprzedniej generacji i kompatybilności wstecznej z USB 2.0 oraz USB 3.2 Gen1, ulepszony protokół USB 3.2 Gen 2 jest dostępny zarówno w nowym, odwracalnym złączu USB Type-C, jak i tradycyjnym USB Type-A - dla większej zgodności z szeroką gamą urządzeń.

Dźwięk Hi-Fi

- Wysokiej klasy kondensatory audio
- Ekranowanie ścieżek dźwiękowych (Audio Noise Guard)

Przyjazna i prosta obsługa

Innowacyjna i intuicyjna konstrukcja sprzętowa, oprogramowanie i interfejs BIOS, pozwalające stworzyć swój własny styl.

Projekty EZ-Latch

Przyjazne dla użytkownika rozwiązania upraszczające montaż.

UC BIOS

- Przeprojektowany interfejs UI i UX Intuicyjny interfejs użytkownika z estetycznym wyglądem.
- Szybki dostęp 9 konfigurowalnych skrótów w trybie Easy Mode.
- PerfDrive Ekskluzywne ustawienia BIOS optymalizujące wydajność w zależności od konfiguracji chłodzenia.

PCIe EZ-Latch

Łatwe odblokowanie zatrzasku złącza PCIe przy demontażu karty graficznej.

Q-FLASH PLUS

Łatwa aktualizacja BIOS-u bez konieczności instalacji CPU, pamięci RAM czy GPU.

GIGABYTE Control Center

Zunifikowana platforma programowa obejmująca wiele produktów GIGABYTE.